

Lekka zaprawa klejowa o szerokim obszarze zastosowania

Właściwości i zastosowanie:

Nowa generacja lekkich zapraw klejowych wyróżnia się wysoką wydajnością oraz bardzo szerokim spektrum zastosowania. MULTILIGHT może służyć jako zaprawa cienko-, średnio-warstwowa, zaprawa o konsystencji rozplývnej jak również jako zaprawa wyrównująca. Przy zastosowaniu zaprawy MULTILIGHT mogą być wykonywane okładziny ściennie i podłogowe z gresu, ceramiki szklonej, kamionki, płytek ciągnionych, podłogowych płytek klinkierowych, płytek klinkierowych, płytek ręcznie formowanych, cotto, płytek szklanych, małej i średniej mozaiki i mozaiki szklanej. Materiał ten nadaje się do klejenia płyt izolacyjnych i lekkich płyt budowlanych. Należy zwrócić uwagę, aby płyty o gładkiej powierzchni (np. z polistyrenu ekstrudowanego) uszorstkować.

Z uwagi na wysoką zdolność odkształcania MULTILIGHT doskonale nadaje się do pewnego układania płytek na silnie obciążanych powierzchniach, takich jak fasady, balkony i tarasy, gotowe elementy betonowe oraz ogrzewane powierzchnie podłogowe.

Jako podłoża nadają się beton, beton komórkowy tynki (z grupy CS II, CS III lub CS IV wg normy PN-EN 998-1:2004; wytrzymałość na ściskanie $\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$), tynk gipsowy (wg normy PN-EN 13279-1:2007; wytrzymałość na ściskanie $\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$), mur pełnospoinowy (materiału nie wolno stosować na murach mieszanych), BOTAMENT® płyta budowlana, stare okładziny ceramiczne, płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo - włókninowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe jak również wewnątrz stabilne podłoża stalowe i posypane piaskiem jastrychy z asfaltu lanego.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być suche, czyste, nie-przemarznięte i nośne. Należy usunąć z niego tłuszcz, stare powłoki malarskie, nacieki cementowe, środki antyadhezyjne i inne luźne części znajdujące się na nim. Powierzchnia ścian powinna być do lica i pionowa.

Tolerancje podłoża na ścianach i podłogach do 20 mm mogą być niwelowane w jednym cyklu roboczym bezpo-

średnio zaprawą MULTILIGHT. Wyrównanie podłoża może być również wykonane przy zastosowaniu masy wyrównawczej BOTAMENT® M 100, a na podłogach masą samopoziomującą BOTAMENT® M 50 / M 51. Beton oraz gotowe części betonowe powinny mieć przynajmniej 3 miesiące.

MULTILIGHT można stosować na wszystkich izolacjach podpłytkowych znajdujących się w ofercie BOTAMENT.

Przed przystąpieniem do układania płytek na tynkach gipsowych jak również jastrychach cementowych i anhydrytowych należy wykonać badanie wilgotności podłoża (aparatem CM). Wilgotność związana na jastrychach cementowych powinna wynosić maksymalnie 2%, względnie 1,8% na ogrzewanych powierzchniach podłogowych. Wilgotność jastrychów anhydrytowych nie powinna przekraczać 0,5% oraz 0,3% na powierzchniach ogrzewanych. Tynki CS II i CS III powinny mieć grubość przynajmniej 10 mm, powinny być suche oraz mieć chropowatą powierzchnię. Tynki gipsowe powinny być jednowarstwowe o minimalnej grubości 10 mm, nie mogą być wygładzone. Wilgotność związana podłożu gipsowych może wynosić max. 1%. Podłoża gipsowe, płyty gipsowo - kartonowe oraz jastrychy anhydrytowe należy przed klejeniem zagruntować BOTAMENT® D 11.

W przypadku klejenia na starych okładzinach ceramicznych oraz silnie przylegających powłokach malarskich należy zwrócić uwagę, aby na 24 godz. przed przystąpieniem do właściwego układania płytek wykonać tzw. „szpachlowanie drapane” przy użyciu MULTILIGHT. Alternatywnie w przypadku prac wykonywanych wewnątrz pomieszczeń polecamy naniesienie warstwy gruntującej BOTAMENT® D 15.

Podłoża stalowe należy zagruntować BOTAMENT® E 120 i posypać piaskiem kwarcowym.

Podczas klejenia płytek na jastrychach anhydrytowych oraz na ogrzewanych podłożach należy przestrzegać wytycznych i norm.

MULTILIGHT

- bardzo stabilna zaprawa, także do płyt wielkoformatowych (C2 TE)
- bardzo wysoka wydajność
- bardzo elastyczna wg normy PN-EN 12002 (S1)
- na prawie wszystkie podłoża
- do układania prawie wszystkich okładzin ceramicznych
- na ściany i podłogi
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- jako masa szpachlowa do nierównych podłoży, do 20 mm
- bardzo długi czas otwarty oraz czas przeznaczony na korektę
- bardzo dobre wypełnienie pod płytką

Lekka zaprawa klejowa o szerokim obszarze zastosowania

Baza materiałowa:

kombinacja cementu z mineralnymi materiałami wypełniającymi i dodatkami z tworzyw sztucznych

Odporność na temperaturę:

od -15°C do +70°C

Optymalna ilość wody:

ok. 40% masa szpachlowa
ok. 42% zaprawa średniowarstwowa
ok. 45% zaprawa cienkowarstwowa
ok. 53% zaprawa rozplýwna

Proporcja mieszanki:

ok. 6 l wody masa szpachlowa
ok. 6,3 l wody zaprawa średniowarstwowa
ok. 6,75 l wody zaprawa cienkowarstwowa
ok. 7,95 l wody zaprawa rozplýwna

Czas dojrzewania:

ok. 3 min.

Czas nakładania:

ok. 30 min.

Czas obróbki:

ok. 3 - 4 godz.

Maksymalna grubość nałożenia:

20 mm

Chodzenie i spoinowanie:

następnego dnia

Pełne obciążenie:

po ok. 48 godz.

Temperatura obróbki:

od +5°C do +30°C

Środki do czyszczenia:

w świeżym stanie materiału: woda,

po wyschnięciu: środkami do usuwania nalotów cementowych

Obróbka:

MULTILIGHT rozprowadza się ciągle mieszając z zimną czystą wodą przy użyciu wiertarki wolnoobrotowej z mieszadłem. Do wymieszania 15 kg proszku należy użyć od ok. 6-7,95 l wody. Miesza się tak długo, aż powstanie jednorodna masa. Po czasie dojrzewania wynoszącym ok. 3 min. należy materiał jeszcze raz krótko zamieszać. MULTILIGHT wolno obrabiać w ciągu ok. 3 - 4 godz. Stężony materiał nie może być ponownie zamieszany i obrabiany, gdyż nie osiągnie się końcowej trwałości.

Najpierw nanosi się na podłoże cienką warstwę kontaktową przy użyciu gładkiej części pacy. Następnie pacą zębata równomiernie rozprowadza się zaprawę na powierzchni. Płytki układa się lekko dociskając i przesuwając w łożu klejowym.

Klejenie płyt izolacyjnych może odbywać się zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Na podłożach gipsowych i anhydrytowych należy przestrzegać wytycznych i zaleceń producenta gipsu.

Wskazówki:

Wszystkie wymienione czasy odnoszą się do temperatury +23°C i 50% względnej wilgotności powietrza. Wyższe temperatury i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza opóźniają czas obróbki i przebieg wiązania.

Należy przestrzegać wytycznych zawartych w kartach technicznych produktów, które są stosowane w połączeniu z MULTILIGHT.

Przed klejeniem na podłożach zawierających gips, a szczególnie przy użyciu MULTILIGHT jako masy wyrównawczej lub zaprawy średniowarstwowej należy sprawdzić jakość podłoża. W przypadku jastrychów z lanego asfaltu MULTILIGHT można stosować jako zaprawę cienkowarstwową lub o konsystencji rozplýwnej.

Przy klejeniu na podłożach stalowych prosimy o kontakt z technikiem zastosowań.

Krytyczne podłoża takie jak płyty kartonowo - gipsowe i podłoża na bazie drewna nie nadają się jako podłoże

pod płytki szklane. Spodnia strona musi być odporna na związki alkaliczne. Płytek nie należy układać bezspoinowo. Szerokość spoiny musi być min. 3 mm a max. 5 mm. Przy wszystkich powierzchniach większych niż 15 m² należy wykonać dylatacje. Należy układać tzw. metodą Buttering-Floating tzn. smarowanie podłoża i płytki. Przy płytkach większych niż 30 x 30 cm prosimy o kontakt z technikiem zastosowań. Należy przestrzegać wytycznych producenta płytek. Do spoinowania zalecamy zaprawę MULTIFUGE Schmal.

Przy klejeniu płyt i płytek na fasadach należy przestrzegać określonych norm i wytycznych.

Kartę bezpieczeństwa produktu otrzymają Państwo na życzenie.

Produkt należy stosować wyłącznie z dodatkami zawartymi w karcie technicznej.

W celu osiągnięcia optymalnych parametrów technicznych przed zastosowaniem należy wykonać próbę w specyficznych warunkach budowy.

Zużycie jako z. cienkowarstwowa:

Paca zębata:

4 mm-ząbki = ok. 1,0 kg proszku/m²

6 mm-ząbki = ok. 1,5 kg proszku/m²

8 mm-ząbki = ok. 2,1 kg proszku/m²

Zużycie jako z. średniowarstwowa:

ok. 3,5 kg proszku/m²

Zużycie jako zaprawa rozplýwna:

Paca zębata:

8 mm-ząbki = ok. 2,1 kg proszku/m²

10 mm-ząbki = ok. 2,4 kg proszku/m²

Opakowanie:

15-kilogramowe worki papierowe.

Przechowywanie:

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Termin przechowywania w oryginalnie zamkniętych opakowaniach wynosi 12 miesięcy.